

康强电子

公司成立于1992年6月，2002年10月完成股份制改造，2007年3月2日在深交所上市（康强电子，002119）。是一家专业从事各类半导体封装材料开发、生产、销售的高新技术企业。主要生产各类半导体塑封引线框架、键合丝。引线框架包括冲制和蚀刻二种工艺生产的集成电路框架系列、表面贴装系列、LED表面贴装阵列系列、电力电子系列和分立器件系列，年生产能力超过1000亿只；键合丝包括键合金丝、键合铜丝系列产品，生产能力达3.6亿米，产品为国内外主要芯片封装企业采用。公司还生产切割加工用电极丝、多工位集成电路框架用级进模具等产品。

公司占地约8.1万m²，建筑面积约10.58万m²，员工近1000人，拥有3家全资子公司。

为了降低生产成本、提高生产效率，针对资源环境保护，公司经过工艺改造、技术创新，在国内首先实现生产点镀银引线框架，与过去全镀银产品相比大量节约了白银。自主研发的电镀废水回收处理设施，采用“分质分流、膜法处理、在线回用”技术，大部分生产废水经处理后直接会用到电镀生产线，回用率达到85%以上，实现了资源循环、节能降耗、绿色发展。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/krdz-876816.html>